

PROGRAMMKOMMISSION

Vorsitzender der Programmkommission

B. Enser

Wissenschaftlicher Tagungsleiter

M. Nowotnick, Universität Rostock

Mitglieder

J. Denzel, Airbus Defence and Space GmbH, Ulm
M. Eisenbarth, ZF Automotive Germany GmbH, Alfdorf
R. Fiehler, KSG Leiterplatten GmbH, Gornsdorf
A. Fix, Robert Bosch GmbH, Schwieberdingen
J. Franke, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
S. Fritzsche, Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG, Hanau
U. Grimmer-Herklotz, Felder GmbH, Oberhausen
S. Härter, Siemens AG, Erlangen
M. Hauer, Dyconex AG, Bassersdorf, Schweiz
A. Hensel, Siemens AG, Erlangen
T. Huesgen, Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten
M. Kubanek, DVS e.V., Düsseldorf
J. Nicolics, Technische Universität Wien, Österreich
M. Oppermann, Technische Universität Dresden
U. Pape, Volkswagen AG, Wolfsburg
T. Rapala-Virtanen, EIPC, Pernö, Finnland
M. Reichenberger, Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm
A. Reinhardt, SEHO Systems GmbH, Kreuzwertheim
T. Scharf, Infineon Technologies AG, Regensburg
H. Schimanski, Fraunhofer ISIT, Itzehoe
M. Schleicher, SEMIKRON International GmbH, Nürnberg
R. Schnabel, VDE/VDI-GMM, Offenbach am Main
M. Schneider-Ramelow, Fraunhofer IZM, Berlin
D. Schucht, Lackwerke Peters GmbH & Co. KG, Rot am See
H. Schweigart, Zestron Europe GmbH, Ingolstadt
R. Seidel, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
J. Thüsing, Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co. KG, Balve
J. Trodler, Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG, Hanau
S. Uredat, VDE/VDI Innovation + Technik GmbH, Berlin
C. Weiß, ZVEI e.V., Frankfurt am Main
P. Wild, RehmThermal Systems GmbH, Blaubeuren
K. Wilke, Siemens AG, Berlin
J. Wolf, Würth Elektronik GmbH & Co. KG, Niedernhall
A. Zimmermann, Hahn-Schickard, Stuttgart

TAGUNGSORGANISATION EBL 2024

VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikrosystem- und
Feinwerktechnik (GMM)
Merianstraße 28, 63069 Offenbach am Main
Tel.: 069-6308 - 227
E-Mail: gmm@vde.com
www.ebl-fellbach.de

PARTNER



Elektronische Baugruppen und Leiterplatten



Call for Papers

Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2024

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
mit smarterer Elektronik

12. GMM/DVS-Tagung

04. – 06. März 2024
Schwabenlandhalle Fellbach

www.ebl-fellbach.de

SPONSOR WERDEN AUF DER EBL 2024

Möglichkeiten hierzu finden Sie unter:
www.ebl-fellbach.de oder rufen Sie uns direkt an:
Tel.: 069-6308 - 227

Titelbild: © Fraunhofer IZM/Volker Mai



ZIELSETZUNG DER TAGUNG

EBL 2024

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz mit smarter Elektronik

Bereits in den 1940er und 50er Jahren wurden die Grundlagen der Künstlichen Intelligenz entwickelt. Dass wir heute geradezu einen Hype der KI-Themen erleben, liegt vor allem daran, dass erst in den letzten Jahren die technologische Entwicklung eine sinnvolle und effiziente Anwendung ermöglichte und sich daraus auch Geschäftsmodelle entwickelten.

Voraussetzungen waren vor allem die Chip- und die Baugruppenttechnologie, welche für eine smarte Elektronik benötigt wird, als auch die Software- und Systemumgebung zur Anwendung und Umsetzung. Aber nicht nur die Technologien haben sich weiterentwickelt, sondern auch die Gesellschaft und die globalen Erfordernisse. So ist es heute für die Menschheit wichtiger denn je, unsere begrenzten Ressourcen effizient und nachhaltig zu verwenden. Dabei spielt die Entwicklung und Anwendung smarter Elektronik eine Schlüsselrolle. Beispielsweise wären die Fortschritte der Leistungselektronik, die entscheidend für die Energiewende sind, ohne eine intelligente Anpassung der verschiedenen Komponenten der Energiesysteme nicht effizient anwendbar. Aber auch die Fertigung der Elektronik selbst muss nachhaltiger und energieeffizienter werden, wofür ebenfalls smarte Elektronik erforderlich ist. Aufbauend auf den Konzepten der Industrie 4.0 kann heute durch maschinelles Lernen und intelligente Datenverarbeitung eine neue Qualität erreicht werden, welche sich gesamtheitlich in der „Digitalen Transformation“ abbilden lässt. Die elektronischen Baugruppen sind sowohl Mittel zum Zweck als auch Gegenstand dieser Entwicklungen.

Die Tagung EBL 2024 will dazu ihren Beitrag leisten, zur Diskussion anregen und somit der wichtigen Stellung unserer Industrie bei diesem Themengebiet Rechnung tragen.

Wir freuen uns auf zahlreiche Vortragseinreichungen.

Bernd Enser

Vorsitzender der
Programmkommission

Prof. Dr. Mathias Nowottnick

Wissenschaftlicher
Tagungsleiter

THEMEN DER TAGUNG

- Digitalisierung, Industrie 4.0, Machine Learning, KI
- Intelligente Systemkonzepte, Designtools, Tests und Simulation
- Neue Materialien
- Energieeffizienz
- Funktions- und Schaltungsträger
- Modul- und Baugruppenfertigung
- AVT, Weichlöten, Kleben, Sintern, Bonden, Lasern
- Prozesssimulation und -steuerung
- Traceability, Compliance, Produkt- und Prozesssicherheit
- Testmethoden, Zuverlässigkeit und Analytik
- Trends, Nachhaltigkeit, flexible Fertigungsverfahren

APPLIKATIONEN

- Mobilität, Transportation,
- Harsh Environment,
- Industrieelektronik, -automation
- Energieerzeugung, -speicherung, -verteilung
- Leistungselektronik
- Messtechnik
- Medizintechnik
- Sicherheitstechnik
- Smart Home und IoT
- Datentechnik
- Digitale Kommunikation
- Hochfrequenztechnik
- Photoniksysteme
- Sensorik

EBL-PREIS FÜR DEN WISSENSCHAFTLICHEN NACHWUCHS

Zusammen mit dem DVS bietet die GMM mit der EBL als wichtigster deutschsprachiger Konferenz auf dem Gebiet der Aufbau- und Verbindungstechnik in der elektronischen Baugruppenfertigung ein Forum für Experten aus Industrie und Forschung. Belohnt wird der beste Beitrag mit einem „Nachwuchs-Preis“. Anlässlich der EBL 2024 werden wir deshalb wieder eine eigene Nachwuchs-Session mit anschließender Verleihung einer Urkunde und einem Preisgeld anbieten.

EINREICHUNG VON BEITRÄGEN

Bitte erstellen Sie ein ca. 200 Wörter umfassendes Abstract mit vollständigen Kontaktdaten der Autoren und Angabe mindestens eines der „Themen der Tagung“. Die Abstracts werden in einem elektronischen Tool gesammelt, das Sie unter

www.ebl-fellbach.de

finden.

Die Programmkommission wählt die eingereichten Beiträge nach folgenden Kriterien aus:

- Die Arbeit ist neu und wurde an keiner Stelle des In- und Auslands vor der Tagung veröffentlicht.
- Die Zielsetzung und die Ergebnisse der Arbeit müssen klar beschrieben sein.

Die Autoren werden benachrichtigt, ob ihr Beitrag angenommen wurde und erhalten dann eine Schreibanleitung für ihr Manuskript. Mit der Annahme des Beitrags wird anschließend ein „full paper“ mit einer Länge von sechs Seiten erwartet. Bitte verwenden Sie dazu die Rubrik *Einreichung von Beiträgen* auf der Website der Veranstaltung.

Die Tagungssprache ist Deutsch. Die Teilnehmer der Tagung erhalten vor Tagungsbeginn einen zitierfähigen Tagungsband.

TERMINE

Deadline für Abstracts	23. Juni 2023
Autorenbenachrichtigung	11. September 2023
Abgabe der Papers	15. November 2023

TABLETOP-AUSSTELLUNG

Im Rahmen der Tagung wird Firmen und Instituten die Möglichkeit gegeben, ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot in einer Tabletop-Ausstellung zu präsentieren. Bitte sprechen Sie uns an und reservieren Sie Ihre Ausstellungsfläche rechtzeitig!